

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于2021年度公开发行可转换公司债券

募集资金运用可行性分析报告

为充分发挥公司技术和经营优势，扩大公司电子材料业务的生产经营规模，降低我国印制电路板产业关键材料对外依赖程度、实现关键材料国产化、完善印制电路板产业链布局，满足印制电路板产业持续发展的重大需求，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金，用于相关电子材料产品项目建设。

一、本次募集资金使用计划

本次公开发行可转债募集资金总额预计不超过240,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目所属区域	实施主体	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	年产4.2亿平方米感光干膜项目	广东省江门市	广东福斯特新材料有限公司	112,568.52	90,000.00
2	年产2.4万吨碱溶性树脂项目	广东省江门市	广东福斯特新材料有限公司	30,493.70	20,000.00
3	年产1,000万平方米挠性覆铜板项目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子材料有限公司	66,544.00	60,000.00
4	补充流动资金项目	-	本公司	70,000.00	70,000.00
合计				279,606.22	240,000.00

上述项目中，“年产4.2亿平方米感光干膜项目”和“年产1,000万平方米挠性覆铜板项目”产品均为印制电路板制造所需的关键原材料。其中感光干膜产品用于印制电路板（PCB）制造时设计线路图的图像转移，是PCB加工的关键耗材；挠性覆铜板（FCCL）产品是柔性印制电路板（FPC）的加工基材，是FPC加工的核心原材料。“年产2.4万吨碱溶性树脂项目”是为感光干膜项目配套建设，碱溶性树脂为感光干膜产品生产所需的核心原材料，建设该项目是实现感光干膜产品核心原材料自主可控的需求。

若本次公开发行可转债实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司

将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）年产4.2亿平方米感光干膜项目

1、项目基本情况

项目名称：年产4.2亿平方米感光干膜项目

实施主体：广东福斯特新材料有限公司（公司全资子公司）

实施地点：广东省江门市新会区

总投资额：112,568.52万元

建设内容：本项目拟新建8条生产线，形成年产4.2亿平方米感光干膜生产能力，满足公司电子材料业务快速发展和实现进口替代的需要。

项目建设期：本项目建设期为3.5年。

2、项目投资概算

项目计划投资额112,568.52万元。其中土地购置投入9,000.00万元，土建投资42,443.00万元，设备投资41,125.52万元，铺底流动资金20,000.00万元。本次拟以募集资金投入金额为90,000.00万元。

3、项目经济效益

根据项目可行性研究报告，项目完全达产后可实现年均销售收入179,340.00万元，项目内部收益率为13.69%（所得税后），投资回收期为9.47年（所得税后，含建设期），具备较好的经济效益。（注：由于“年产2.4万吨碱溶性树脂项目”是本项目的核心原材料配套项目，在计算本项目内部收益率、投资回收期等经济效益指标时，包含了“年产2.4万吨碱溶性树脂项目”的投入，“年产2.4万吨碱溶性树脂项目”不再单独核算经济效益。）

4、项目的审批备案及用地情况

本项目的备案、环评等审批流程尚在办理过程中。

本项目需在广东省江门市新会区新增用地150亩，所涉土地使用权尚在取得过程中。

(二) 年产2.4万吨碱溶性树脂项目

1、项目基本情况

项目名称：年产2.4万吨碱溶性树脂项目

实施主体：广东福斯特新材料有限公司（公司全资子公司）

实施地点：广东省江门市新会区

总投资额：30,493.70万元

建设内容：本项目与“年产4.2亿平方米感光干膜项目”同步建设，建成后形成年产2.4万吨碱溶性树脂生产能力，为“年产4.2亿平方米感光干膜项目”配套供应核心原材料。

项目建设期：本项目建设期为3.5年。

2、项目投资概况

项目计划投资额30,493.70万元。其中土地购置投入3,000.00万元，土建投资6,032.00万元，设备投资11,461.70万元，铺底流动资金10,000.00万元。本次拟以募集资金投入金额为20,000.00万元。

3、项目经济效益

碱溶性树脂为感光干膜产品的核心原材料，本项目实施后，所生产的碱溶性树脂产品将全部用于“年产4.2亿平方米感光干膜项目”配套，实现感光干膜核心原材料的自主可控，有利于深化公司在PCB行业电子材料产业链的布局。因此，本项目不单独核算效益，其效益核算一并包含在“年产4.2亿平方米感光干膜项目”之中。

4、项目的审批备案及用地情况

本项目的备案、环评等审批流程尚在办理过程中。

本项目需在广东省江门市新会区新增用地50亩，所涉土地使用权尚在取得过程中。

（三）年产1,000万平方米挠性覆铜板项目

1、项目基本情况

项目名称：年产1,000万平方米挠性覆铜板项目

实施主体：杭州福斯特电子材料有限公司（公司全资子公司）

实施地点：浙江省杭州市临安区高新技术产业园金马区块

总投资额：66,544.00万元

建设内容：本项目拟新建7条生产线，形成年产1,000万平方米无胶型挠性覆铜板生产能力，满足公司电子材料业务快速发展和实现进口替代的需要。

项目建设期：本项目建设期为3年。

2、项目投资概况

项目计划投资额66,544.00万元。其中土地购置投入1,600.00万元，土建投资11,200.00万元，设备投资48,744.00万元，铺底流动资金及预备费5,000.00万元。本次拟以募集资金投入金额为60,000.00万元。

3、项目经济效益

根据项目可行性研究报告，项目完全达产后可实现年均销售收入82,000.00万元，项目内部收益率为14.50%（所得税后），投资回收期为8.36年（所得税后，含建设期），具备较好的经济效益。

4、项目的审批备案及用地情况

本项目的备案、环评等审批流程尚在办理过程中。

本项目利用位于浙江省杭州市临安区高新技术产业园金马区块的55亩土地，其中15亩为已有土地，另需新增用地40亩，新增用地所涉土地使用权尚在取得过程中。

（四）补充流动资金项目

公司综合考虑行业发展趋势、财务状况、经营规模、市场融资环境以及未来战

略规划等自身及外部条件，为进一步优化公司资本结构，满足公司未来业务快速增长的营运资金需要，公司拟将本次发行募集资金中的70,000.00万元用于补充流动资金，占本次发行募集资金总额不超过 30.00%。

三、本次募集资金投资项目的背景

（一）降低印制电路板产业关键材料对外依赖程度、实现关键材料国产化、完善印制电路板产业链布局的重要举措

本次募集资金投资项目所涉及产品分别为感光干膜、碱溶性树脂和无胶型挠性覆铜板，均为印制电路板产业国产化程度较低的关键原材料，具体情况如下：

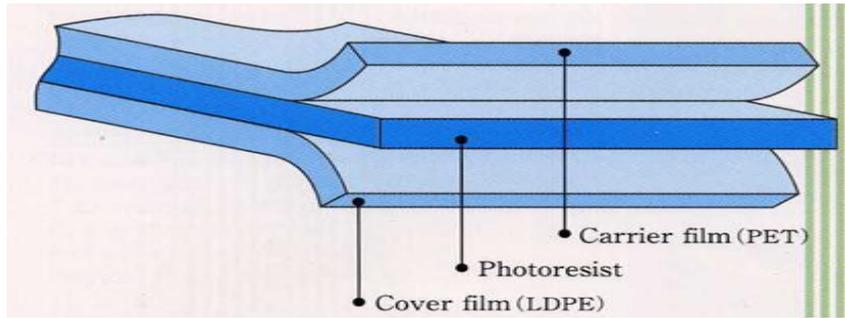
1、感光干膜

感光干膜又称干膜光刻胶，主要用于印制电路板（PCB）制造时设计线路图的图像转移，属于PCB光刻胶的一种。

光刻胶是电子信息产业重要工艺材料，进入壁垒较高。光刻胶又称光致抗蚀剂，是利用光化学反应，经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模板（光罩）转移到待加工基片上的图形转移介质，主要用于电子信息产业的精细线路图形加工，是微细加工技术最为关键的材料之一。按下游应用领域区分，光刻胶主要可分为PCB光刻胶、面板显示光刻胶、半导体光刻胶和其他，在全球市场占比各为25%左右，下游市场需求结构较为均衡；但全球光刻胶整体供应高度集中，核心技术由日、美等国际公司掌握，其中JSR、东京应化、信越化学及富士胶片四家日企占据了全球70%以上的市场份额。

感光干膜属于PCB光刻胶的一种，是PCB加工的关键耗材，约占PCB产业总成本的3%¹，但国产化程度低。PCB光刻胶可分为干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻焊油墨三类，其中感光干膜是由预先配制好的光刻胶（Photoresist）在精密的涂布机上和高清洁度的条件下均匀涂布在载体聚酯薄膜（PET膜）上，经烘干、冷却后，再覆上聚乙烯薄膜（PE膜），收卷而成卷状的薄膜型光刻胶。感光干膜的结构示意图如下：

¹资料来源：前瞻产业研究院



感光干膜具有分辨率高、线条精度高、成像连续性好等特点，有利于实现PCB制造工序的机械化和自动化，成为PCB加工过程中关键的辅助材料。受益于中国PCB产业景气度的持续提升，日本、台湾地区的PCB光刻胶厂商自2002年起开始在中国建立生产工厂，至今仍掌握着主要的市场份额。在干膜光刻胶领域，中国台湾长兴材料、日本旭化成、日本日立化成三家公司占据了全球超过80%的市场份额，中国内地市场的感光干膜几乎全依赖于进口。虽然我国是全球PCB最大生产国，但内地市场感光干膜基本依赖于进口的局面，不仅提高了我国PCB企业的生产成本、限制PCB行业规模的扩大，还可能制约PCB产业及电子信息产业的持续发展。

2、碱溶性树脂

碱溶性树脂属于光刻胶专用电子化学品之一，且是实现感光干膜性能的关键原材料。光刻胶专用电子化学品是指生产光刻胶使用的化学原料，包括光刻胶光引发剂、光刻胶树脂、单体（活性稀释剂）和添加助剂四类；其中，树脂用于将光刻胶中不同材料聚合在一起，构成光刻胶的骨架，决定光刻胶的硬度、柔韧性、附着力等基本属性，是实现光刻胶性能（如解析、显影性、光敏性、去膜特性等）的关键原材料之一。在感光干膜领域，所用树脂以碱溶性树脂为主，碱溶性树脂对感光干膜的成膜性能有非常大的影响，成膜性能决定了感光干膜在曝光后能保持同样的厚度，继而保证感光干膜成像的分辨率。

由于碱溶性树脂的性能直接影响感光干膜的性能，除日本综研化学株式会社、日本DIC株式会社及国内的强力新材等少数企业对外供应外，多由感光干膜厂商自主设计开发和生产，以保证感光干膜的性能能够符合下游客户的要求。

3、挠性覆铜板

挠性覆铜板（FCCL）是柔性印制电路板（FPC）的加工基材，其质量与性能决定了FPC的性能高低、应用领域以及市场附加值大小，是FPC的核心原材料。FPC是

PCB的一种，具有配线密度高、轻薄、可弯折、可立体组装等特点，适用于小型化、轻量化的电子产品，符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势，被广泛运用于智能手机、电脑、可穿戴设备、汽车电子、5G通讯基站等现代电子产品。

根据产品结构中是否有胶粘剂，挠性覆铜板可分为三层挠性覆铜板（3L-FCCL）与两层挠性覆铜板（2L-FCCL）两大类。三层挠性覆铜板由基膜、胶层和铜箔组成，又称为有胶型挠性覆铜板；两层挠性覆铜板由基膜和铜箔组成，因不含胶层，又称为无胶型挠性覆铜板。其中，无胶型挠性覆铜板由于不含胶层，整体厚度更薄、表面轮廓更低、剥离力更强且尺寸安定性更高，更能满足精细线路FPC的加工制程，更好地满足各类电子产品“轻薄短小”、高频高速化的趋势，属于较为高端的产品。

目前，挠性覆铜板的生产商主要为日韩企业和台资企业，国内很少有企业在生产。根据日本矢野经济研究所株式会社发布的《全球挠性覆铜板（FCCL）行业及重点企业现况的调查报告》，全球主要挠性覆铜板生产商有新日铁住金化学株式会社、宇部兴产株式会社、有泽制作所株式会社、SKInnovationCo.,LTD.、LS电线公司、台虹科技股份有限公司、新扬科技股份有限公司等。因此，中国大陆挠性覆铜板产业的发展滞后于PCB产业的整体发展情况。

综上所述，建设感光干膜、碱溶性树脂和挠性覆铜板生产项目，有利于降低国内PCB产业对上述关键原材料的对外依赖程度，是PCB行业关键材料国产化、完善产业链布局的重要举措，积极响应了我国正在大力推动的“畅通国内大循环、促进国内国际双循环、加快培育完整内需体系”的远景目标。

（二）满足印制电路板市场需求稳定增长、产业持续向中国转移、下游新应用领域发展所带来的关键原材料需求

PCB被誉为“电子产品之母”，几乎是所有电子产品中不可或缺的元件，其周期性受单一行业影响较小，主要受宏观经济周期性波动以及电子信息产业整体发展情况的影响。根据Prismark数据，2020年全球PCB市场（含FPC，下同）预计增长2%，为625亿美元，预计未来年度，随着计算机、5G通讯、物联网、人工智能、工业4.0等不断发展与进步，PCB产业仍将持续平稳增长。根据Prismark预测数据，2021-2025年年全球PCB市场增速在4%-5%，到2025年将达792亿美元。



资料来源：Prismark

进入二十一世纪以来，受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求，亚洲地区尤其是中国大陆成为全球最重要的电子产品制造基地，全球PCB产业重心亦逐渐向中国大陆转移，日本、美洲、欧洲和亚洲其他地区PCB产值在全球的占比不断下降，产能在近十余年内呈现出由日韩及中国台湾向中国大陆转移的趋势。Prismark数据显示，2019年亚洲PCB产值在全球占比达到92.5%，其中中国大陆市场产值为329.4亿美元，市场占比达53.7%，已成为全球最大的PCB生产基地。预计2019-2024年，全球不同国家及地区的PCB产业将呈现不同的发展态势，中国大陆仍将是主要生产国中增速最快的国家。

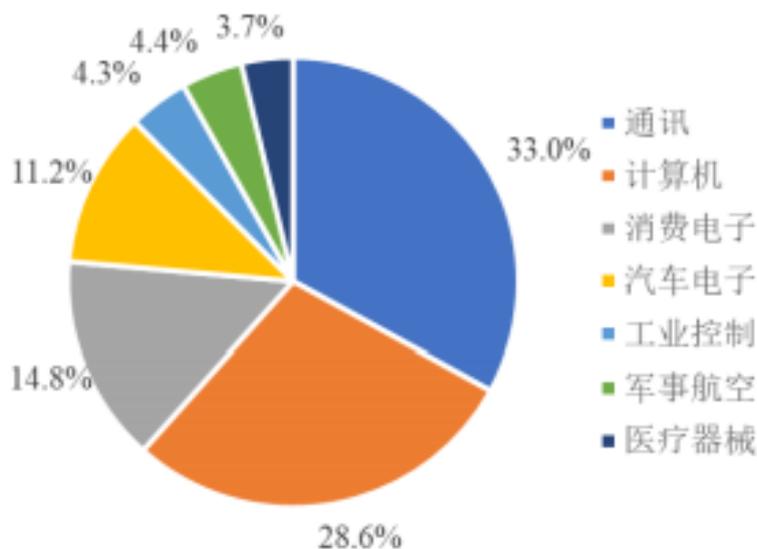
单位：亿美元

地区 时期	中国大陆		日本		亚洲其他		美洲		欧洲	
	产值	同比	产值	同比	产值	同比	产值	同比	产值	同比
2015	267.3	0.4%	56.6	-4.1%	182.3	-21.1%	28.3	0.4%	18.8	-13.0%
2016	271.2	1.5%	52.5	-7.1%	171.7	-5.8%	28.0	-1.0%	18.6	-1.0%
2017	297.3	9.6%	52.6	0.1%	191.7	11.6%	28.2	0.9%	18.8	0.9%
2018	327.0	10.0%	54.4	3.5%	194.2	1.3%	28.2	-0.2%	20.2	7.1%
2019	329.4	0.7%	52.9	-2.8%	185.0	-4.8%	27.6	-1.9%	18.2	-9.7%
2024F	417.7	/	61.4	/	227.9	/	31.7	/	19.7	/
2019-2024CAGR	4.9%		3.0%		4.3%		2.8%		1.6%	

资料来源：Prismark，高工产业研究院（GGII）整理

PCB产品的主要应用领域包括通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业电子、军事航空和医疗器械等。从2019年全球PCB市场应用领域分布占比来看，通

讯电子市场仍然是PCB产品应用占比最大的领域，市场份额为33.0%，其下游应用包括移动手机、通信基站建设两个方面；计算机领域排名第二，市场占比28.6%；消费电子产品排名第三，市场占比14.8%。2019年，按应用领域分的全球PCB市场应用领域分布图如下：



资料来源：Prismark，高工产业研究院（GGII）整理

其中在FPC细分领域方面，由于与其他印制电路板相比，FPC配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲且灵活性强，在消费电子器件（如智能手机、可穿戴设备）中的应用较广，并逐步拓展到动力电池、汽车电子、工控医疗等领域；加之近年来，全球FPC逐步朝着线宽细、布线密、工艺精的超精化方向发展，FPC市场规模保持着与PCB产业同步增长的趋势。根据Prismark数据统计，2015-2019年挠性板占全球PCB市场份额始终在20%左右，2019年FPC产值为122亿美元，预计2022年全球FPC产值可达到149亿美元。

下游新应用领域的不断发展是PCB产业持续增长的新动力。近年来，随着5G、云计算、智能汽车等新的电子信息产业结构性增长热点的出现，PCB行业有望迎来新的增长驱动。5G网络建设的大规模推进及商用，将催化电子产品相关技术和应用更快发展、迭代、融合，5G通信基站建设量有望大幅增加，应用于5G网络的交换机、路由器、光传送网等通信设备对PCB的需求有望随之增加；云计算的普及和数据流量随之爆发式增长的背景下，高速、大容量、高性能的服务器将不断发展，将会对高层数、高密度、高速PCB产品形成大量需求；随着电动汽车的普及，动力电池需求、汽车电子化程度正在迅速提高，不仅新增大量对车用PCB产品的需求，对

高端PCB的需求也在迅速增长。

在印制电路板市场需求稳定增长、产业持续向中国转移、下游新应用领域不断发展的背景下，PCB产品有望更多地向高密度、高精度、多层化、轻薄化和挠性等高技术含量方向发展，将带动PCB光刻胶和FPC需求量的持续增长，从而不断增加对感光干膜、碱溶性树脂和挠性覆铜板等关键原材料的质量和数量需求。因此，建设上述产品的生产项目，将有利于把握印制电路板产业不断增长的需求。

（三）国家产业政策积极支持印制电路板行业发展

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，与国民经济发展密切相关。感光干膜、碱溶性树脂和挠性覆铜板作为PCB产业的关键原材料，在产业链中发挥重要作用，有望持续受到国家政策的鼓励和支持。近年来重要的相关产业政策如下：

主要政策	颁布机构	颁布时间	相关内容
《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》	发改委、财政部、商务部	2016年	将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子元器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”列入鼓励发展的重点行业
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016年	提出“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”，推动“印刷电子”等领域关键技术研发和产业化，提升“专业电子材料”供给保障能力
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	发改委	2017年	明确将“高密度互联印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录，将“新兴膜材料”作为新兴功能材料产业列入指导目录
《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	2018年	包含了“光敏树脂材料（集成电路、印刷线路板制作及电子器件等）”
《印制电路板行业规范条件》	工信部	2019年	加强印制电路板行业管理，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展
《产业结构调整指导目录（2019年本）》	发改委	2019年	新型电子元器件（包括高密度印刷电路板和柔性电路板等）被列为鼓励类目录。 新型电子元器件（包括高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料被列为鼓励类目录

《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	发改委、科技部、工信部、财政部	2020年	加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	国务院	2020年	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。 培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平

四、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

(一) 项目实施的必要性

1、深挖关键共性技术体系，丰富公司产品结构，扩大电子材料业务规模

公司主要致力于薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售。目前，公司主要产能和主要收入来自于光伏胶膜、光伏背板等光伏领域，电子材料产能和收入占比相对较低。

公司利用多年的技术积累、生产管理经验，构建了涵盖流涎挤出加工、精密涂布、可控交联、高分子异质界面粘接等全工艺流程的单/多层聚合物功能薄膜材料制备技术体系。通过深挖该关键共性技术体系，公司已经成功将业务进一步拓展到感光干膜、挠性覆铜板等电子信息产业关键原材料领域。本次募投项目的顺利实施将有助于进一步丰富公司的产品线、扩大电子材料领域的收入占比，可有效地减轻公司收入主要来自于光伏产业链的风险，从而提高公司的市场竞争力以及整体抗风险能力，为公司可持续发展提供新的动力。

2、有助于提高公司的客户资源利用率，为下游客户提供更加丰富的产品配套

目前，公司感光干膜产品已经进入深南电路、深联科技、景旺电子等国内大型PCB厂商的供应体系。由于挠性覆铜板与感光干膜产品下游需求客户均为PCB生产商，具有较强的客户资源协同潜力。本次募投项目的顺利实施，将为现有感光干膜客户进一步提供产品供应能力的同时，可进一步提供挠性覆铜板产品，既有利于为客户提供丰富的产品配套服务，又有助于提高公司的客户资源利用效率，使得公司在较低客户开发成本水平的基础上扩大整体业务规模，从而产生较大的客户资源协

同效应。

3、完善生产区域布局，进一步提升与下游客户的粘性

感光干膜主要用于PCB生产，其客户主要为PCB企业。感光干膜作为PCB加工使用的关键辅助材料，其存储期仅有半年，且存储条件相对严格。因此，感光干膜企业/仓库一般建在PCB企业附近。

PCB行业整体呈现一定的区域性特征。就中国大陆而言，华东和华南沿海地区经济发展水平较高，且电子信息产业比较发达，上述两个区域为PCB产业大型厂商、高端和高附加值产品、上下游配套产业较为集中的地区。

目前，公司已在浙江省布局了感光干膜产能。本次募投项目中的感光干膜和碱性树脂生产项目将布局于广东省江门市，挠性覆铜板生产项目将布局于浙江省。本次募投项目的实施将有效覆盖华东市场和华南市场，起到完善生产区域布局、提升与下游客户粘性的作用。

（二）项目建设的可行性

1、PCB全产业链自主配套的内在需求，将加快关键原材料进口替代进程

以感光干膜为代表的电子化学品位于PCB产业链的前端，其工艺水平和产品质量将直接对元器件的功能和性状构成重要影响。近年来，随着下游电子相关行业向中国地区转移，制造环节竞争日趋激烈，使用性价比高的国产电子化学品，逐步成为电子制造企业的必然选择，为国内电子化学品企业迎来了新增市场需求。同时，由于电子化学品对于产品纯度、洁净度有很高的要求，长途运输不利于产品品质及安全，下游企业倾向就近采购；并且在电子产品差别化程度不断提高的背景之下，下游客户对上游企业的技术服务、共同开发的要求日益提高，而国内优势企业机制灵活，与下游企业沟通和共同研发较为顺畅。因此，关键原材料的进口替代成为必然趋势。

此外，在贸易战等事件的倒逼下，国家产业安全日益凸显，电子信息产品全产业链自主配套能力建设成为国家的重要战略发展方向，进一步加快了感光干膜、挠性覆铜板等关键电子化学品的进口替代进程。以公司为代表的、具备相关产品积累和储备的优势企业，将有望迅速占领市场先机。

2、成熟的单/多层聚合物功能薄膜材料制备技术体系，为本次募集资金投资项目的实施奠定了坚实基础

公司自成立以来，一直致力于单/多层聚合物功能薄膜材料产品体系的研发、生产和销售。公司设有浙江省光伏封装材料工程技术研究中心、福斯特新材料重点企业研究院及经CNAS资质认定的检测中心等研发平台，是国家高新技术企业。经过十余年的研发创新及产业化实践，公司构建了涵盖流涎挤出加工、精密涂布、可控交联、高分子异质界面粘接等全工艺流程的单/多层聚合物功能薄膜材料制备技术体系，形成了独特的核心竞争能力，成长为业内龙头企业。此外，公司具备产业链核心设备自主研发设计能力、生产及品质控制全流程智能管理系统自主开发能力，是业内少数具备产业链自主研发配套能力的高新技术企业。

公司数年前即对感光干膜、挠性覆铜板等电子材料产品投入大量资源进行重点研发和产业化探索，自2015年起逐步成功切入感光干膜、挠性覆铜板等电子材料领域。其中在感光干膜领域，公司基于长期利用PET膜生产光伏背板所积累的技术，成功以PET膜为载体开发出感光干膜产品；在挠性覆铜板领域，公司采用聚酰亚胺（PI）树脂作为基膜材料，结合公司的精密涂布技术和精细化生产流程，将聚酰亚胺树脂材料涂覆于铜箔上，形成聚酰亚胺薄膜与铜箔复合的2L-FCCL。目前，公司已具备了感光干膜、挠性覆铜板大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的认可，为募集资金投资项目的实施奠定了坚实的基础。

五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次可转债发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金投资项目成功实施后，公司将进一步改善现有产品结构，增强市场竞争力；本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，增加公司新的利润增长点，提高市场占有率，增强公司核心竞争力和持续盈利能力。

（二）本次可转债发行对公司财务状况的影响

本次可转债发行完成后，公司的资产规模将相应增加，资金实力得到进一步提升，为后续发展提供有力保障。可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，正常情况下，公司对可转债募集资金运用

带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息。若未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。

本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，项目达产后，公司的营业收入和净利润将有效提升，盈利能力得到进一步的改善，公司的整体业绩水平将得到稳步提升。

六、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、印制电路板产业发展需求以及公司战略发展的需要，具有良好的市场前景和经济效益。项目实施后，将有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，进一步强化公司竞争优势，符合本公司及全体股东的共同利益。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

2021年7月5日